



Tagesordnung

Thema: 74. Treffen des Arbeitskreises
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und
Verbindungstechnologien“

Datum: **23. Februar 2022, 10.00 Uhr**

Ort: Fraunhofer IZM, Berlin
Online via MS Teams

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung
Herr Walter, Fraunhofer IZM, Berlin
- 2 10:10 Uhr
Einfluss der Heelschwächung auf die Lebensdauer von Al-Drahtbonds
Frau Prof. U. Geissler, TH-Wildau, Wildau
- 3 10:50 Uhr
Experimentelle und numerische Studie zu thermischen Kopplungen von Si-Flip-Chip auf FR4 Substrat unter Berücksichtigung des Wärmespreizwinkels bei natürlicher oder forcierter Konvektion
Herr T. Nowak, BTU-Cottbus, Cottbus
- 4 11:30 Uhr
Der digitale Zwilling in der Industrialisierung-Vorhersagen, die sich rechnen
Herr T. Weber, Zollner Elektronik AG, Zandt
- 5 12:15 Uhr
Mittagspause

- 6 13:00 Uhr
Digitalisierung in der Materialforschung
Herr Ch. Schweizer, Fraunhofer IWM, Freiburg
- 7 13:40 Uhr
*Nahtlose Integration von Versuchs- und Simulationsdaten zu konsistenten
Werkstoffmodellen mit JMatPro und Matplus EDA®*
Herr B. Koch, MATPLUS GmbH, Wuppertal
- 8 14:20 Uhr
Kaffeepause
- 9 14:30 Uhr
*Modifiziertes Zugversuchkonzept zur mechanische Charakterisierung von
ultrafeinen Kupferschichten*
Herr A. Keller, Fraunhofer IZM, Berlin
- 10 15:15 Uhr
Abschlussdiskussion
Herr Walter, Fraunhofer IZM, Berlin

Ende der Veranstaltung gegen 15:30 Uhr